

エンタープライズサーバ「EP8000 シリーズ」のラインアップを強化 POWER5+プロセッサを最大 16way 搭載可能なモデルを追加



EP8000 570
(POWER5+搭載)

日立製作所 情報・通信グループ(グループ長&CEO: 古川 一夫、以下、日立)は、米国 IBM 社の UNIX オペレーティングシステム(OS)である AIX 5L を採用しているエンタープライズサーバ「EP8000 シリーズ」において、最新の POWER5+プロセッサを最大 16way まで搭載可能な「EP8000 570」「EP8000 560Q」および最大 4way まで搭載可能な「EP8000 520Q」を新たにラインアップに追加し、2月23日から販売を開始します。

■新モデルの特徴

(1)「EP8000 570」POWER5+搭載モデル

POWER5+(2.2/1.9GHz)を最大 16way 構成まで可能なモデルで、POWER5 を搭載した従来の「EP8000 570」に比べトランザクション処理性能を約 26%向上し、上位モデルに迫る高い処理性能を実現しています。また、メモリ容量は最大 512GB まで、拡張 PCI スロット数は最大 163 スロットまで増強でき、拡張性にも優れているため、中/大規模のデータベースやオンライントランザクション処理システムに適しています。

(2)「EP8000 560Q」

2way 構成の POWER5+(1.5GHz)を 2 個搭載したプロセッサモジュールを採用し、「EP8000 570」の半分となる 8U サイズで最大 16way 構成まで可能なモデルです。価格性能比では「EP8000 570」POWER5 搭載モデルに比べ約 2 倍以上向上しており、ミッドレンジモデルながらエントリーモデルなみの価格性能比を実現しています。特にプロセッサ性能を重視する中規模データベースなどに適しています。

(3)「EP8000 520Q」

2way 構成の POWER5+(1.5GHz)を 2 個搭載したプロセッサモジュールを採用し、「EP8000 520」の 2 倍となる 4way 構成を実現しています。下位クラスのエントリーモデルながら、上位クラスに迫る性能スケーラビリティと I/O 拡張性を両立しています。

加えて、エントリーモデルの「EP8000 550」「EP8000 520」POWER5+(1.65GHz)搭載モデルも同時にラインアップに追加しています。

新モデルはいずれも、TCO(Total Cost of Ownership)の削減とビジネス規模の変化への迅速な対応を可能とする高度なハードウェア資源仮想化機能をサポートしています。また、ハードウェアとしてだけでなく、ホットスタンバイ構成における本番系/待機系の切替えが十数秒と極めて短い時間で実行できるなど、システム運用面での高い信頼性・可用性も備えています。

■新製品の概要

モデル	形状	プロセッサ (周波数)	最大プロセッサ数 (way)	メモリ容量	拡張 PCI スロット数
EP8000 570	ラックマウント	POWER5+(2.2/1.9GHz)	16	4GB～512GB	最大 163
EP8000 560Q		POWER5+(1.5GHz)		8GB～128GB	最大 12
EP8000 550	ラックマウント/タワー	POWER5+(1.65GHz)	4	4GB～64GB	最大 61
EP8000 520Q		POWER5+(1.5GHz)		4GB～32GB	最大 34
EP8000 520		POWER5+(1.65GHz)	2	2GB～32GB	最大 34

■新製品の価格と出荷時期

モデル	形状	価格	出荷時期
EP8000 570	ラックマウント	16,680,090 円～ (税抜 15,885,800 円～)	1.9GHz : 2006 年 3 月 31 日 2.2GHz : 2006 年 4 月 17 日
EP8000 560Q		9,637,635 円～ (税抜 9,178,700 円～)	2006 年 4 月 17 日
EP8000 550	ラックマウント/タワー	3,598,350 円～ (税抜 3,427,000 円～)	2006 年 3 月 31 日
EP8000 520Q		3,511,725 円～ (税抜 3,344,500 円～)	
EP8000 520		1,519,665 円～ (税抜 1,447,300 円～)	

■他社商標注記

- ・AIX、IBM は、米国における米国 International Business Machines Corp.の登録商標です。
- ・POWER5、POWER5+は、米国における米国 International Business Machines Corp.の商標です。
- ・UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
- ・その他、記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

■製品情報

<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/EP8000/>

■取扱事業部・照会先

株式会社 日立製作所 情報・通信グループ
 エンタープライズサーバ事業部 企画部【担当:喜多村】
 〒259-1392 神奈川県秦野市堀山下1番地
 電話:0463-87-6786(ダイヤルイン)

以上

■新製品の特徴

1. 各モデルの特徴

(1)「EP8000 570」POWER5+搭載モデル

POWER5+(2.2/1.9GHz)を最大 16way まで搭載可能なミッドレンジモデルです。これまでの POWER5 を搭載した「EP8000 570」に比ベトランザクション処理性能を約 26%向上し、上位モデルに迫る高い処理性能を発揮します。また価格性能比においても同等クラスの他社モデルと比べ、優れています。

スケーラブルなシステム構築を実現するスタックブル SMP 構成を採用しており、基本ブロックとなる 4way 構成の CPU ドロワー(4U(*1))を最大 4 つまで接続することにより 16way 構成まで拡張可能で、業務の規模や処理量に応じて、最適なコストでシステムの導入および拡張が行えます。メモリは最大 512GB、PCI-X スロットは I/O ドロワーを接続することで最大 163 スロットまで増強できるなど、処理性能だけでなくシステム拡張性も優れています。優れた性能と拡張性を兼ね備えた「EP8000 570」POWER5+搭載モデルは、中規模から大規模の業務システム、データベース、オンライントランザクション処理システムなどに対応可能なモデルです。

(2)「EP8000 560Q」

「EP8000 570」と同様にスタックブル SMP 構成を採用したミッドレンジモデルです。2way 構成の POWER5+(1.5GHz)を 2 個搭載したプロセッサモジュールを採用し、基本ブロックとなる 8way 構成の CPU ドロワー(4U(*1))を最大 2 つまで接続することにより、16way 構成まで処理量に応じて最適なコストでシステムの導入および拡張が行えます。「EP8000 570」の半分の筐体サイズで 16way 構成まで拡張可能で、加えてこれまでの POWER5 搭載の「EP8000 570」に比べ価格性能比が約 2 倍以上に向上しました。他社ミッドレンジモデルと比較して性能スケーラビリティに優れたシステムをエントリーモデルなみの価格で導入することができます。

メモリは最大 128GB、PCI-X スロットは最大 12 スロットまで増強可能となっており、特にプロセッサ性能を重視する中規模データベースなどに適したモデルです。

(3)「EP8000 520Q」

2way 構成の POWER5+(1.5GHz)を 2 個搭載したプロセッサモジュールを採用したエントリーモデルで、「EP8000 520」に比べ 2 倍のプロセッサ数の 4way 構成を実現しています。これにより、これまでの 1.9GHz の POWER5+を搭載した「EP8000 520」に比ベトランザクション処理性能が約 68%向上しました。筐体はラックマウント型(4U(*1))とタワー型の 2 種類を用意しています。

メモリは最大 32GB、PCI-X スロットは最大 34 スロット(*2)まで増強できるなど、エントリーモデルとして非常に高い拡張性を備えており、プロセッサ性能を重視する小規模の業務システム、データベースなどに最適なモデルです。

(4)「EP8000 550」「EP8000 520」POWER5+(1.65GHz)搭載モデル

エントリーモデルの「EP8000 550」「EP8000 520」において、昨年 10 月に発表した 1.9GHz の POWER5+を搭載したモデルに加え、今回新たに 1.65GHz の POWER5+を搭載したモデルを追加しました。これらのモデルは 1.5GHz の POWER5 を搭載した「EP8000 550」「EP8000 520」の後継にあたるもので、従来モデルに比ベトランザクション処理性能が約 10%向上しました。本モデルの追加により、優れた性能を発揮する POWER5+搭載モデルをより低コストに導入することが可能です。

(*1) ラック搭載時の占有サイズ(1U=高さ約 44.5mm)

(*2) ラックマウント型のみ。

2. ハードウェア資源仮想化機能をサポート

新モデルは、現行 POWER5 搭載モデル同様、マイクロパーティショニング機能に対応した動的論理分割(Dynamic LPAR (*3))に対応しています。マイクロパーティショニング機能により、1 つのプロセッサ

を論理的に分割し最大 10 パーティションで共有することが可能です。「EP8000 570」「EP8000 560Q」では最大 160 パーティション(16way 構成時)、「EP8000 550」「EP8000 520Q」では最大 40 パーティション(4way 構成時)、「EP8000 520」では最大 20 パーティション(2way 構成時)に分割できます。

物理的なプロセッサ数にとらわれることなく各パーティションにプロセッサ能力を割り当てられるため、システムの使用効率高めることが可能です。このほか、上位機種と同様に LAN およびストレージの仮想化機能もサポートしています。

これらハードウェア資源仮想化機能により、ハードウェアリソースのより有効な活用による TCO 削減や、ビジネス規模の変化に合わせた迅速かつ柔軟なシステム構成変更・増強を行うことができます。

(*3) LPAR:Logical Partition

3. メインフレームクラスの信頼性と可用性

今回の新モデルも従来の「EP8000 シリーズ」と同様、動的プロセッサ切り離し機能、PCI バス障害回復機能、動的 PCI アダプタ切り離し機能など、様々な高信頼化機能をサポートしています。これにより、システム停止につながる障害発生を大幅に低減します。

また、高可用性ソフトウェア「HA モニタ」とスケラブルデータベース「HiRDB」によるクラスタ構成において、現用系システムの OS 障害発生と同期した待機系システムへの即時切替え通知や、現用系システムから待機系システムへの共有ディスクの高速切替えを実現するソフトウェア「HA Booster Pack for AIX」を用いることにより、これまで数分程度の時間を必要とした障害時のシステム系切替えを十数秒という極めて短い時間に実行することができるなど、ハードウェアとしてだけでなく、システム運用面での高い信頼性・可用性も備えています。

4. 最新のソフトウェア環境を提供

オペレーティングシステム(OS)は、POWER5+/POWER5 搭載モデルの性能・機能を最大限に引き出す米国 IBM 社の最新版 UNIX OS「AIX 5L V5.3」に対応しています。

「AIX 5L V5.3」は、優れたパフォーマンス、信頼性・可用性、Linux との高い親和性に加え、セキュリティや Java 実行環境などネットビジネス構築のためのオープンかつミッションクリティカルな基盤機能も提供します。ミドルウェア/アプリケーションには、基幹業務システムで実績のある日立オープンミドルウェア製品に加え、DBMS(*4) 製品 Oracle® や SAP® R/3®を含む SAP の E ビジネスプラットフォーム mySAP.com®など豊富な ISV(*5) 製品が利用でき、幅広いニーズに対応したシステムを構築することが可能です。

(*4) DBMS:Database Management System

(*5) ISV:Independent Software Vendor

■ 他社所有商標に関する表示

- AIX、IBM は、米国における米国 International Business Machines Corp.の登録商標です。
- Java 及びすべての Java 関連の商標及びロゴは、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。
- Oracle は、Oracle Corporation の登録商標です。
- POWER5+、POWER5 は、米国における米国 International Business Machines Corp.の商標です。
- SAP®、R/3®、mySAP.com®は、SAP AG のドイツおよびその他の国における登録商標または商標です。
- UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
- その他、記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

■新製品の仕様

モデル		EP8000 570 POWER5+搭載モデル	
形状		ラックマウント	
プロセッサ	プロセッサ名称	POWER5+	
	クロック・レート (GHz)	1.9	2.2
	プロセッサ数 (way)	4~16 *3	
レベル2キャッシュ(MB *1)		1.9 (2wayあたり)	
レベル3キャッシュ(MB *1)		36 (2wayあたり)	
メモリ容量	最小~最大(GB *1)	4~256 *3	4~512 *3
ディスク容量	最小~最大(GB *2)	73.4~42,432 *3 *4	
拡張PCI-X スロット本数	CPUドロー	6	
	I/Oドロー(ディスクベイ無)	6	
	I/Oドロー(ディスクベイ有)	7	
CPUドロー数		1~4	
I/Oドロー数		0~20	
外形寸法 (W×D×H:mm)	CPUドロー	483×790×174 (4U *5)	
	I/Oドロー(ディスクベイ無)	217×711×168 (4U *5 *6)	
	I/Oドロー(ディスクベイ有)	482×610×178 (4U *5)	
	搭載筐体	標準ラック筐体/低層ラック筐体 *7	
電源電圧(V)		200~240 (単相)	
省エネ法に 基づく表示	区分	F	
	エネルギー消費効率	0.08	
	搭載OS	AIX 5L version 5.3 または AIX 5L version 5.2	

エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

モデル		EP8000 560Q	
形状		ラックマウント	
プロセッサ	プロセッサ名称	POWER5+	
	クロック・レート (GHz)	1.5	
	プロセッサ数 (way)	4/8/16 *8	
レベル2キャッシュ(MB *1)		1.9 (2wayあたり)	
レベル3キャッシュ(MB *1)		36 (2wayあたり)	
メモリ容量	最小~最大(GB *1)	8~128 *8	
ディスク容量	最小~最大(GB *2)	146.8~3,600 *8	
拡張PCI-Xスロット本数		6 (CPUドローあたり)	
CPUドロー数		1~2	
外形寸法 (W×D×H:mm)	CPUドロー	483×790×174 (4U *5)	
	搭載筐体	標準ラック筐体/低層ラック筐体 *7	
電源電圧(V)		200~240 (単相)	
省エネ法に 基づく表示	区分	F	
	エネルギー消費効率	0.0397	
搭載OS		AIX 5L version 5.3 または AIX 5L version 5.2	

エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

モデル		EP8000 550 POWER5+(1.65GHz)搭載モデル	
形状		タワー	ラックマウント
プロセッサ	プロセッサ名称	POWER5+	
	クロック・レート(GHz)	1.65	
	プロセッサ数(way)	2	2/4
レベル2キャッシュ(MB *1)		1.9 (2wayあたり)	
レベル3キャッシュ(MB *1)		36 (2wayあたり)	
メモリ容量	最小～最大(GB *1)	4～32 *9	4～64 *10
ディスク容量	最小～最大(GB *2)	146.8～2,400	146.8～16,492.8 *11
拡張PCI-Xスロット本数		5	5～61 *11
I/Oドロー数		—	0～8
外形寸法 (W×D×H:mm)	CPUドロー	—	437×686×178 (4U *5)
	I/Oドロー	—	482×610×178 (4U *5)
	搭載筐体	201×779×533	標準ラック筐体/低層ラック筐体 *7
電源電圧(V)		100～127 (単相)	100～127 *12 /200～240 (単相)
省エネ法に 基づく表示	区分	F	
	エネルギー消費効率	0.0331	
搭載OS		AIX 5L V5.3 または AIX 5L V5.2	

エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

モデル		EP8000 520Q	
形状		タワー	ラックマウント
プロセッサ	プロセッサ名称	POWER5+	
	クロック・レート(GHz)	1.5	
	プロセッサ数(way)	4	
レベル2キャッシュ(MB *1)		1.9 (2wayあたり)	
レベル3キャッシュ(MB *1)		36 (2wayあたり)	
メモリ容量	最小～最大(GB *1)	4～32 *9	
ディスク容量	最小～最大(GB *2)	146.8～2,400	146.8～9,446.4 *13
拡張PCI-Xスロット本数		6	6～34 *13
I/Oドロー数		—	0～4
外形寸法 (W×D×H:mm)	CPUドロー	—	442×573×172 (4U *5)
	I/Oドロー	—	482×610×178 (4U *5)
	搭載筐体	190×590×535	標準ラック筐体/低層ラック筐体 *7
電源電圧(V)		100～127 (単相)	100～127/200～240 (単相)
省エネ法に 基づく表示	区分	F	
	エネルギー消費効率	0.048	
搭載OS		AIX 5L V5.3 または AIX 5L V5.2	

エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

モデル		EP8000 520 POWER5+(1.65GHz)搭載モデル			
形状		タワー		ラックマウント	
プロセッサ	プロセッサ名称	POWER5+			
	クロック・レート(GHz)	1.65			
	プロセッサ数(way)	1	2	1	2
レベル2キャッシュ(MB *1)		1.9 (1wayあたり)	1.9 (2wayあたり)	1.9 (1wayあたり)	1.9 (2wayあたり)
レベル3キャッシュ(MB *1)		—	36 (2wayあたり)	—	36 (2wayあたり)
メモリ容量	最小～最大(GB *1)	2～32 *9			
ディスク容量	最小～最大(GB *2)	146.8～2,400		146.8～9,446.4 *13	
拡張PCI-Xスロット本数		6		6～34 *13	
I/Oドロー数		—		0～4	
外形寸法 (W×D×H:mm)	CPUドロー	—		442×573×172 (4U *5)	
	I/Oドロー	—		482×610×178 (4U *5)	
	搭載筐体	190×590×535		標準ラック筐体/低層ラック筐体 *7	
電源電圧(V)		100～127 (単相)		100～127/200～240 (単相)	
省エネ法に 基づく表示	区分	F			
	エネルギー消費効率	0.048			
搭載OS		AIX 5L V5.3 または AIX 5L V5.2			

エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

(*1) 1MB(メガバイト)=1,024² バイト, 1GB(ギガバイト)=1,024³ バイトです。

(*2) 1GB(ギガバイト)=1,000³ バイトです。

(*3) CPUドロー 4 台接続時

(*4) I/Oドロー(ディスクベイ有) 20 台接続時。

(*5) ラック搭載時の占有サイズ(1U=高さ約 44.5mm)。

(*6) 4U のラックスペースに 2 台並べて搭載します。

(*7) ラック筐体は、下記のうちから選択できます。

23U ラック筐体(格納サイズ 23U)外形寸法 647×1,104×1,193 (W×D×H:mm)

36U ラック筐体(格納サイズ 36U)外形寸法 647×1,104×1,798 (W×D×H:mm)

42U ラック筐体(格納サイズ 42U)外形寸法 647×1,104×2,015 (W×D×H:mm)

(*8) CPUドロー 2 台接続時

(*9) 2006 年度第 1 四半期サポート予定。それまでは最大 16GB です。

(*10) 2006 年度第 1 四半期サポート予定。それまでは最大 32GB です。

(*11) I/Oドロー 8 台接続時。

(*12) 2way 構成時のみ。

(*13) I/Oドロー(ディスクベイ有) 4 台接続時。

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
